

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2019-014

深圳市民德电子科技股份有限公司

2018年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	275,583,401.86	122,526,500.99	124.92
营业利润	64,246,065.55	47,117,067.23	36.35
利润总额	64,448,177.31	48,090,238.51	34.02
归属于上市公司股东的净利润	53,839,936.94	40,459,916.66	33.07
基本每股收益(元)	0.5982	0.5018	19.21
加权平均净资产收益率	12.28%	13.03%	减少0.75个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	619,048,109.28	447,733,210.10	38.26
归属于上市公司股东的所有者权益	458,627,698.44	419,249,865.66	9.39
股本	90,000,000.00	60,000,000.00	50.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.10	6.99	-27.04

注：本表数据为公司合并报表数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩

报告期内，公司实现营业收入275,583,401.86元，较上年同期增长124.92%；实现利润总额64,448,177.31元，较上年同期增长34.02%；实现归属于上市公司股东的净利润53,839,936.94元，较上年同期增长33.07%。主要原因是：（1）条码识别业务，公司营业收入和净利润较上年度虽小幅下降，但产品结构优化进展显著，二维码识读设备及模组销售占比大幅提升；且本年度公司加大了对合作开发定制芯片和产品核心部件标准化水平的研发力度，随着定制芯片在2019年的投入试产，预期将大幅提升产品性能、降低产品成本，增加产品市场竞争力。（2）半导体业务，公司2018年6月完成重大资产重组项目，进入半导体电子元器件分销行业；交割程序完成后，深圳市泰博迅睿技术有限公司（简称“泰博迅睿公司”）合并日后的经营业绩纳入公司合并范围。且本年度，泰博迅睿公司在合并后获得公司资金等资源注入，经营业绩较上年有大幅增长。（3）公司本年内使用暂时闲置资金购买银行理财产品产生的收益较上年同期增加。（4）公司本年内重大资产重组产生的交易费用、研发费用较上年同期增加较多，对净利润的增长产生一定的抵减效果。报告期内，公司基本每股收益为0.5982元，较上年同期增长19.21%，主要是由于报告期内实现的归属于上市公司股东的净利润较上年增加；报告期内，加权平均净资产收益率为12.28%，较上年同期减少0.75个百分点，主要是由于报告期内平均净资产较上年增加。

2、财务状况

报告期末，公司总资产为619,048,109.28元，较期初增长38.26%，主要是由于报告期内完成泰博迅睿公司的重大资产重组所致。归属于上市公司股东的所有者权益为458,627,698.44元，较期初增长9.39%，主要是由于报告期内实现盈利所致。股本为90,000,000.00元，较期初增长50.00%，主要是由于报告期内资本公积转增股本所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2019年1月29日披露的业绩预告中预计的

业绩不存在差异。

四、其他说明

本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据将在公司2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2. 深交所要求的其他文件。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2019年2月26日